

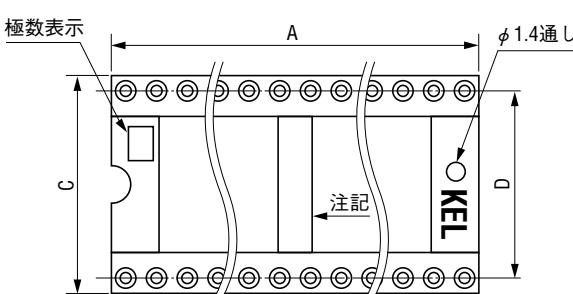
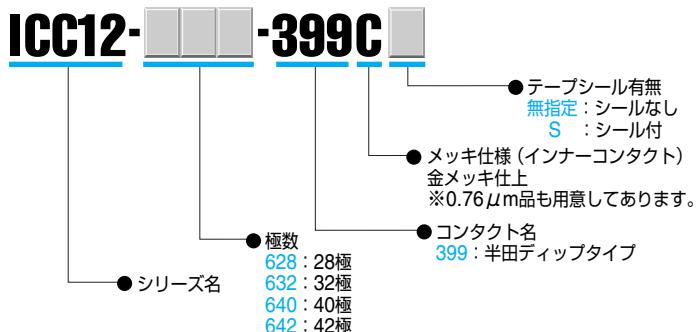
## 特 長

- インナーコンタクトの方向を整列し、信頼性を一段と向上させています。
- 基板面よりEPROM IC実装高さ7mm(使用されるICによって異なります)のロープロファイル化を実現しています。
- ベリリウム銅コンタクトによる多点接触構造です。

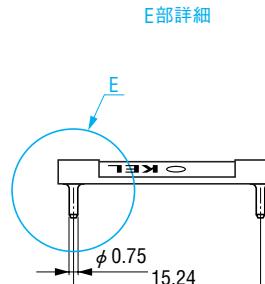
## 仕 様

- インシュレータ材質：ポリブチレンテレフタレート  
(ガラス繊維入り) UL94V-0材
- コンタクト材質：  
(インナーコンタクト) ベリリウム銅  
ニッケル下地、金メッキ仕上  
(アウタースリーブ) 銅合金  
ニッケル下地、錫合金メッキ仕上
- 定格電流：1端子につき1A
- 接触抵抗：20mΩ以下
- 耐電圧：AC700V, 1分間
- 絶縁抵抗：DC500V, 1000MΩ以上
- 使用温度範囲：-65°C ~ +125°C

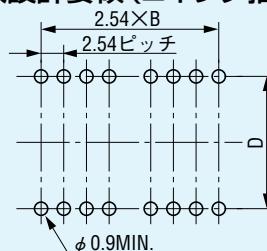
### ● オーダーコード



注記  
28、32ピンは中央リブ1ヶ所  
40、42ピンは中央リブ2ヶ所



### 基板設計要領(コネクタ搭載面)



### ■品名一覧/寸法表 (単位:mm)

極数	品 名	A	B	C	D
28	ICC12-628-399C	35.56	13	17.78	15.24
32	ICC12-632-399C	40.64	15	17.78	15.24
40	ICC12-640-399C	50.80	19	17.78	15.24
42	ICC12-642-399C	53.34	20	17.78	15.24